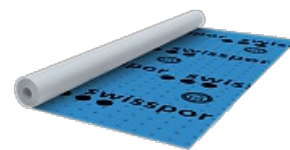


swisspor Lé de sous-couverture Difuplan Top GS 330

Lé de sous-couverture haute technologie avec languettes de recouvrement soudables. Soudable à l'air chaud ou avec le liquide à souder. Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.



Instructions de pose

Pose parallèle à la chanlatte

Sur support résistant à la pression

Recouvrement min. 10 cm

Pente minimum de la toiture: 5°

Fixation du lé uniquement dans la zone de recouvrement

Coller les recouvrements pour protéger des averses et du vent, maroufler soigneusement la zone de collage

Coller les raccords sur tôle et les remontées sur les éléments de construction avec la colle de montage swisspor et, le cas échéant, fixer mécaniquement

Domaines d'utilisation

- Nouvelles constructions et rénovations
- Lé de sous-couverture répondant aux sollicitations élevées et extraordinaires selon la norme SIA232/1 selon SN EN 13859-1:2014
- Soudure à l'air chaud homogène et sans joints grâce au produit swisspor
- Température de soudure entre 200 et 300°C selon les conditions climatiques
- Soudure homogène sans joint avec le liquide à souder swisspor

Caractéristiques techniques

produits	swisspor Lé de sous couverture Difuplan Top GS 330			
Propriétés	Unités	Valeur définie	Tolérance	
Longueur	m	30	-0%	
Largeur	cm	300	-0.5%	+1.5%
Rectitude	mm/10m ¹	< 30		
Classification		E		
Étanchéité à l'eau		W1+		
Veillissement artificiel contre la pénétration d'eau		W1+		
Masse surfacique	g/m ²	340	-2%	+5%
Perméabilité à la vapeur d'eau	m	0,3	0.25	0.4
Résistance à l'allongement MD/CD	N/5cm	330/370	-40	+40
Veillissement artificiel allongement MD/CD	N/5cm	330/370	-40	+40
Éirement MD/CD	%	40/50	-15	+15
Veillissement artificiel éirement MC/DC	%	40/50	-15	+15
Résistance à l'allongement d'une déchirure amorcée MD/CD	N	230/200	-20	+20
Pliage à froid	°C	≤ 20		-20
Stabilité dimensionnelle	%	0	-2	+2
Résistance aux températures	°C		-40	+80
Résistance à la pression de l'eau	cm WS	> 1000	1000	
Étanchéité à la pluie battante		erfüllt		
Exposition aux intempéries	Monate	6		